

1MM-R-D36-VS-00-H-TBP

ⓧ 请勿在新设计中使用

AMPMODU | AMPMODU 小引脚间距

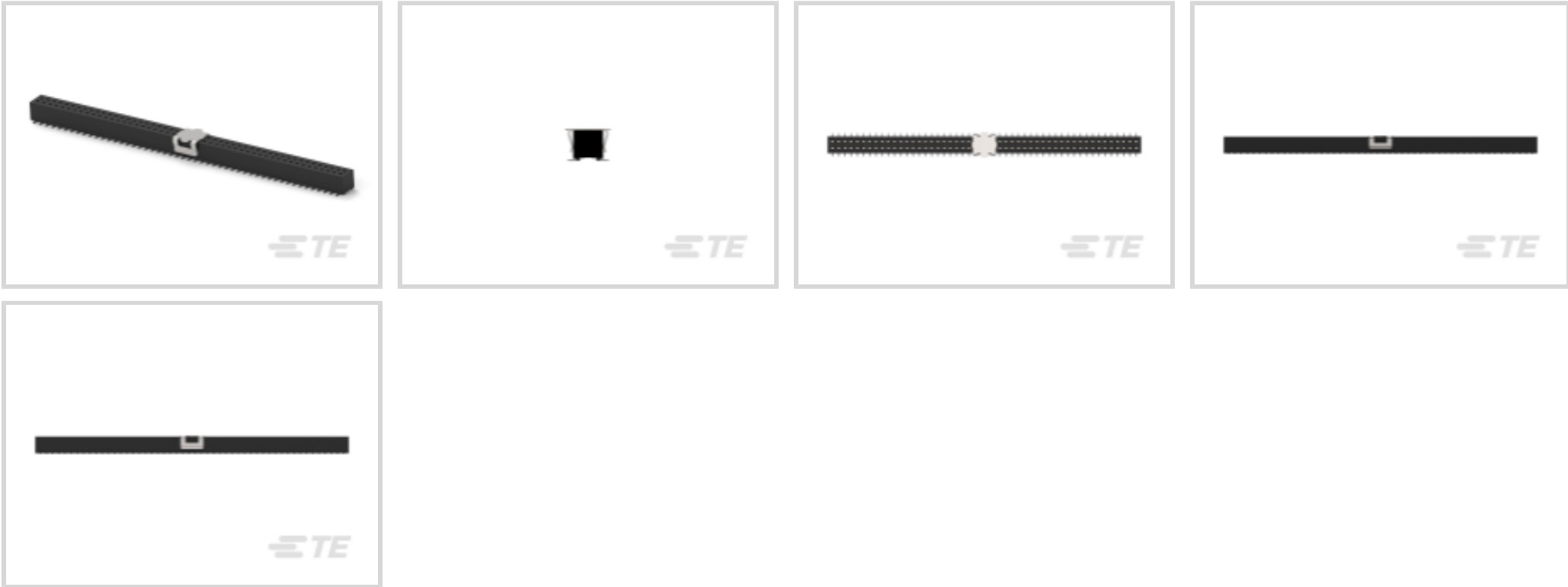
TE 内部编号 3-2267440-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 72 Position, 1 mm  
[.039 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU  
Small Centerline

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: 72

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 施加的压力     | 低        |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 装载位置数量    | 72 |
| 信号位置数量    | 72 |
| 板对板配置     | 平行 |
| 可堆叠       | 否  |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 72 |
| 行数        | 2  |



电气特征

|           |          |
|-----------|----------|
| 工作电压      | 30 VDC   |
| 端接电阻      | 16 mΩ    |
| 介质耐压（最大值） | 1000 VAC |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 装配过程特性材料 | 不锈钢 |
| 主要产品颜色   | 黑色  |

接触件特性

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 端子底板材料             | 镍                |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm[50 μin]  |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[30 μin]   |
| 接合方柱尺寸             | .3 mm[.011 in]   |
| 端子基材               | 磷青铜              |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 亮光               |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光               |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3.81 μm[150 μin] |
| 端子形状和构造            | SMT 引线, 矩形       |
| 端子布局               | 直插式              |
| 端子保护类型             | 闭合入口壳体           |
| 端子接触部长度            | 2 mm             |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)           |
| 端子类型               | 插座               |
| 端子额定电流（最大值）        | 1 A              |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .24 mm[.009 in] |
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .1 mm[.003 in]  |
| PCB 端接方法    | 表面贴装            |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 接合固定    | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |               |
|---------|---------------|
| 接合入口位置  | 底部和顶部         |
| 外壳材料    | LCP           |
| 中心线（间距） | 1 mm[.039 in] |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 行间距        | 1 mm                        |
| 连接器高度      | 3.12 mm                     |
| 连接器长度      | 36.6 mm                     |
| PCB 厚度（建议） | .8 – 1.6 mm[.031 – .063 in] |

使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工组温度范围  | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖    |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

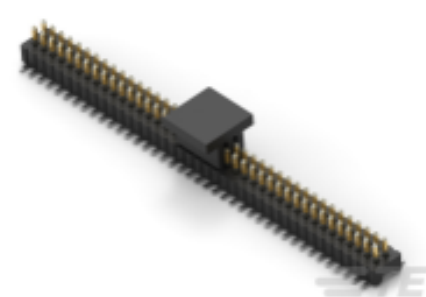
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

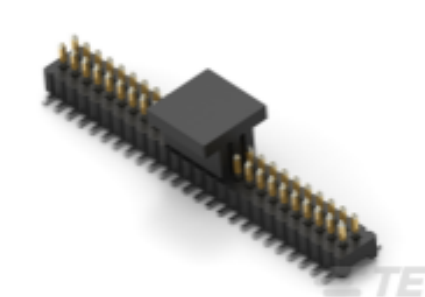


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

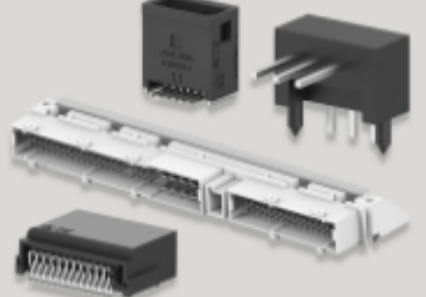


TE 产品编号 8-2331929-6  
SCL 1.0 HDR DRVT USP 072 SMT G3 TR

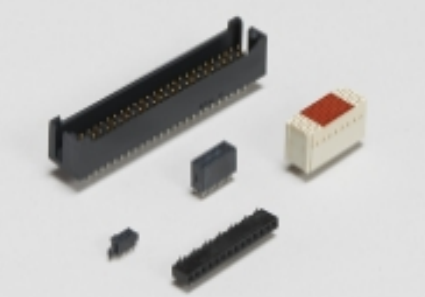


TE 产品编号 3-2331929-6  
SCL 1.0 HDR DRVT USP 072 SMT G3 TBK

该系列中的其他产品 | AMPMODU 小引脚间距



PCB 板端连接器及母端(364)



板对板接头和插座(364)

客户还购买了



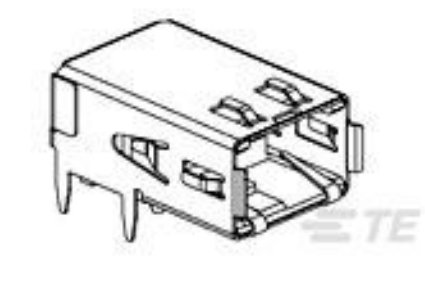
TE 产品编号5-103911-3  
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA



TE 产品编号5-104076-2  
60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN



TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20



TE 产品编号1761072-3  
RECPT,HSSDC2,FIBRE,TRAY PKG

1MM-R-D36-VS-00-H-TBP

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 72 Position, 1 mm [.039 in]  
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU Small Centerline



TE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102  
0.3W

TE 产品编号5146893-2  
1FHR,84,30A/S,S,C,S08,09,10

TE 产品编号1-1437581-1  
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

TE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P

TE 产品编号4-2176391-7  
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号7-2176246-6  
CRGS2512 5% 1M8

文档

产品图纸

SCL 1.0 RCPT DR VT 072 SMT G3 TBK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2267440-6\_10.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2267440-6\_10.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2267440-6\_10.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU 1.0 mm CENTERLINE INTERCONNECTION SYSTEMS

英文版本

Datasheet - AMPMODU Small Centerline

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1MM-R-D36-VS-00-H-TBP

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 72 Position, 1 mm [.039 in]  
Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, AMPMODU Small Centerline



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)